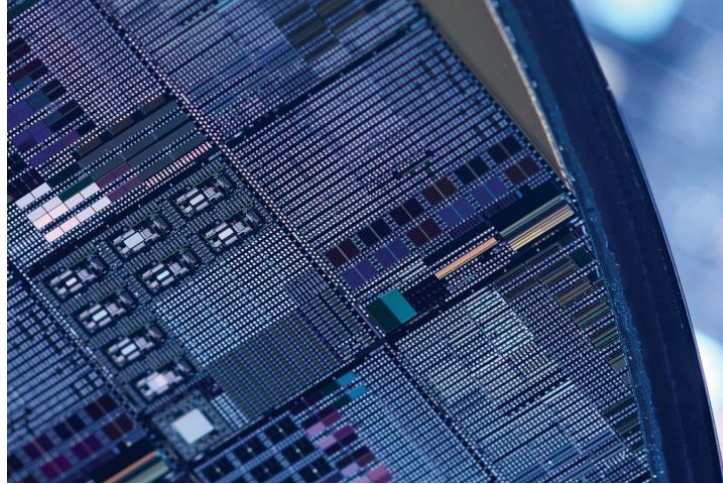


Nexplant MESplus – Wafer 생산 후공정 적용사례



Project Description

- 고객 : Wafer 생산 후공정 전문기업 (L社)
- 솔루션 : Nexplant MESplus, Nexplant FMB, Nexplant QMS, Nexplant EMI, Highway101, RPA
- 범위 : Wafer Bumping through Probe Test & Back-end
 - MES Upgrade, 품질관리, 통합 모니터링, ERP 연동, RunSheet 전산화, SPC 고도화, 장비 PM Sheet 전산화

01 The Challenge

- 노후화된 MES로 인한 시스템 부하
- 원부자재 및 장비 관리 부재
- 품질 관리 고도화 필요
- 각종 Sheet 수기관리 어려움
- 가동률, 실적 모니터링 관리 부재

02 The Solution

- MES Upgrade(고도화, DB Migration) 생산 Lot별 사용 자재 Tracking 및 ERP 연계
 - 원부자재 관리, 분석기능 제공
장비 Tool 관리를 통한 수명, 사용량 관리
 - 전사 표준 SPC 프로세스 정립,
일별/주별/월별/분기별 SPC Reporting 제공
 - MFO를 통한 RunSheet 시스템화
PM 기준정보 관리를 통한 PM Sheet 전산화
 - 장비별 Chamber 가동률 관리, 집계 Report 제공
FMB(Dashboard)를 활용한 모니터링 화면 제공
- * SPC - Statistical Process Control
* MFO - Material, Flow, Oper
* PM - Periodic Maintenance

03 Benefits

- MES Upgrade를 통한 시스템 안정화 및 확장성 확보
 - 원부자재 추적 및 품질 분석기능제공 → 제품 품질 향상
BOM/TOOL 관리 정물일치로 원가체계 확보
 - SPC CTQ Spec 관리 강화
생산정보 추적관리 체계 확보를 통한 업무 효율성 향상
 - Paperless를 통한 원가 절감 및 관리 효율성 증가
 - 실시간 생산 라인 및 실적 현황 모니터링으로
신속한 의사결정 가능
- * BOM - Bill Of Material
* CTQ - Critical to Quality